



台積公司董事會決議

發佈單位：台灣積體電路製造股份有限公司

發佈日期：2026年2月10日

台灣積體電路製造股份有限公司今（10）日召開董事會，會中重要決議如下：

- 一、核准 2025 年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣 3 兆 8,090 億 5,400 萬元，稅後淨利約為新台幣 1 兆 7,178 億 8,300 萬元，每股盈餘為新台幣 66.25 元。
- 二、核准配發 2025 年第四季之每股現金股利 6.0 元，其普通股配息基準日訂定為 2026 年 6 月 17 日，除息交易日則為 2026 年 6 月 11 日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自 2026 年 6 月 13 日起至 6 月 17 日止，停止普通股股票過戶，並於 2026 年 7 月 9 日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為 2026 年 6 月 11 日。
- 三、核准 2025 年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約新台幣 2,061 億 4,592 萬元，其中員工業績獎金約新台幣 1,030 億 7,296 萬元已於每季季後發放，而酬勞（分紅）約新台幣 1,030 億 7,296 萬元將於今年七月發放。
- 四、為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金 449 億 6,200 萬元，內容包括：1. 建置及升級先進製程產能；2. 建置及升級先進封裝、成熟及/或特殊製程產能；3. 廠房興建及廠務設施工程。
- 五、核准於不超過美金 300 億元之額度內增資本公司百分之百持股之子公司 TSMC Global，以降低外匯避險成本。
- 六、核准於不高於新台幣 600 億元之額度內於國內市場分次募集無擔保普通公司債，以支應本公司產能擴充及/或綠色相關支出之資金需求。
- 七、核准召集 2026 年股東常會，並訂於 6 月 4 日上午九時假新竹喜來登大飯店（新竹縣竹北市光明六路東一段 265 號 3 樓）舉行。
- 八、核准以下人事擢升案：
 1. 擢升本公司營運組織晶圓廠營運一副總經理王英郎博士為資深副總經理；
 2. 擢升本公司營運組織先進技術暨光罩工程副總經理張宗生博士為資深副總經理；
 3. 擢升本公司研究發展組織平台研發副總經理吳顯揚博士為資深副總經理；
 4. 擢升本公司研究發展組織平台研發副總經理葉主輝博士為資深副總經理；
 5. 擢升本公司資材管理組織資深處長黃遠國先生為副總經理；
 6. 擢升本公司營運組織十二 B 廠資深廠長田博仁先生為副總經理；
 7. 擢升本公司研究發展組織 10 埃米平台技術資深處長林學仕博士為副總經理；
 8. 擢升本公司業務開發組織先進技術業務開發資深處長袁立本博士為副總經理。



關於台積公司

台積公司成立於 1987 年，率先開創了專業積體電路製造服務之商業模式，自此成為世界領先的專業積體電路製造服務公司。台積公司以領先業界的製程技術及設計解決方案組合支援其客戶及夥伴生態系統的蓬勃發展，以此釋放全球半導體產業的創新。身為全球的企業公民，台積公司的營運範圍遍及亞洲、歐洲及北美，致力成為企業社會責任的行動者。

2025 年，台積公司提供最廣泛的先進製程、特殊製程及先進封裝等 305 種製程技術，為 534 個客戶生產 1 萬 2,682 種不同產品。台積公司企業總部位於台灣新竹。進一步資訊請至台積公司網站 <https://www.tsmc.com.tw> 查詢。

#

台積公司發言人：

黃仁昭
資深副總經理暨財務長

台積公司新聞連絡人：

高孟華
企業公共關係處主管
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5036
Mobile: 0988-239-163
E-Mail: press@tsmc.com

李國維
企業公共關係處
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5037
Mobile: 0988-932-757
E-Mail: press@tsmc.com